株式メモおよびその他のIR情報

株主メモ（株式のご案内）

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
株主確定基準日	定時株主総会　毎年3月31日 期末配当金　毎年3月31日 中間配当金　毎年9月30日 ※期末配当のみとさせていただきます。
定時株主総会	毎年6月開催
単元株式数	100株
証券コード	6258
上場金融商品取引所	ジャスダック証券取引所

株主名簿管理人	大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲2丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 〈郵便物送付先〉 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 〈電話照会先〉 0120-176-417（フリーダイヤル）
公告方法	当社のホームページに掲載します。ただし、事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告します。

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。
証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

その他のIR情報

平田機工株式会社ホームページ
http://www.hirata.co.jp

IR情報
http://www.hirata.co.jp/ir/

2009年7月 当社ホームページのIR情報をリニューアルしました。個人投資家向けのページを新設し、当社の事業内容、業績の推移、あゆみなど様々な情報を掲載しています。ぜひご覧ください。

●IR情報に関するお問い合わせ先
平田機工株式会社　経営企画部　IR･広報室
TEL 096-272-5558
FAX 096-272-3618
E-mail hirata_ir@hirata.co.jp

平田機工株式会社

本　社
〒142-0041 東京都品川区戸越3丁目9-20
TEL.03-3786-1226　FAX.03-3786-1264

熊本本部
〒861-0198 熊本県熊本市植木町一木111
TEL.096-272-0555　FAX.096-272-7901

証券コード：6258

Hirata
The Global Production Engineering Company

第59期
HIRATA REPORT

平成21年4月1日～平成22年3月31日

平田機工株式会社

代表取締役社長　米田　康三　　代表取締役会長　平田　耕也

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。第59期（平成21年4月1日～平成22年3月31日）の事業概況を以下のとおり、ご報告させていただきます。

当期間は、世界同時不況の影響による景気の最悪期からは脱し、一部に持ち直しの動きが見られるものの、個人消費の低迷を背景とするデフレ基調が企業の収益環境を悪化させるなど、先行きの不透明感を払拭できない状況が続きました。

このような情勢のもと、設備過剰感を背景とした設備投資の手控えや、受注価格の低下などの厳しい影響を受け、当期間の連結売上高は、334億円（前年同期比32.7%減）となりましたが、新規分野の受注確保、人件費・労務費の削減や経費の大幅な見直しなどを行った結果、黒字転換を果たすことができました。

事業分野別では、自動車分野において、主力の北米および国内市場の設備投資の抑制が続き、減収となり、FPD分野においても、前期に受注しておりました大型案件の売上を計上いたしましたが、国内およびアジアの市場環境が厳しく推移し、前期の水準には至らず減収となりました。

半導体分野においても、市場の回復基調が見られるものの、上半期における受注低迷により微減となりました。

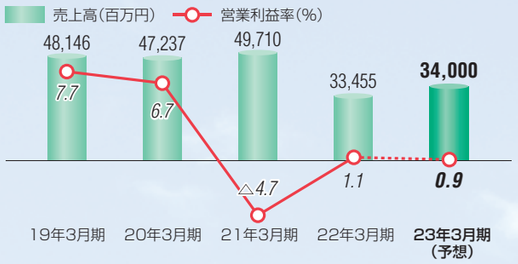
物流機器および家電関連分野においては、厳しい環境でありましたが、家電およびタイヤ業界向け設備の受注確保により増収となりました。

利益面では、緊急対策による固定費の削減、コスト競争力強化のための生産体制の見直しや生産調整などの結果、営業利益は3億64百万円、経常利益は1億80百万円、当期純利益は43百万円とそれぞれ黒字化することができました。

■平成22年3月期 累計実績と通期業績予想（連結）

	平成22年3月期 実績	平成23年3月期予想	
		第2四半期累計	通期
売上高	334億円	170億円	340億円
営業利益	3.6億円	1億円	3億円
経常利益	1.8億円	0億円	1億円
当期純利益	0.4億円	1億円	1.2億円
1株あたり当期純利益	4.19円	9.52円	11.90円
1株あたり配当金	10.00円	―	10.00円

■連結売上高・営業利益率推移



通期業績の見込みについて

各国の経済対策効果や好調な新興国の経済成長に支えられ、世界経済は緩やかな回復基調にありますが、依然として厳しい事業環境が続く見通しであります。当社は、この事業環境の下、中期経営計画「NEXT計画」の2年目として、より戦略的な事業展開を推進すべく、下記の項目を重点的に実行してまいります。

■重点項目

1　コスト競争力の強化

一層のコスト・リダクションを図るため、外注費や調達品価格の見直し、負荷に応じた人員配置の適正化、構想段階におけるローコスト・デザインの実現と原価見積りの精緻化、予実と工程進捗の一体管理、などをこれまで以上に進めてまいります。

2　国内外での営業力強化

本体の事業部と海外子会社の関係をより緊密にして、事業の内外一体運営を図り、お客様のグローバルな事業展開にお応えしてまいります。また、新規のお客様および新規事業分野での営業活動強化のため、4月に東京営業部を新設しました。

3　エンジニアリング力の強化

当社の強みの一つは、お客様の要望に応じた製品を、短期間に開発・設計・試作などを行うエンジニアリング力にありますが、そのさらなる強化のために、事業部単独では十分に対応できない案件などに対応すべく、4月にエンジニアリング室を新設しました。

4　商品企画・開発の加速

昨年設置した開発センターを充実させ、新規事業分野である太陽電池事業については、当社グループの強みを活かしたセミターンキービジネスを展開してまいります。

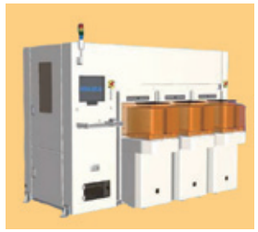
トピックス

450mmウェーハ対応搬送システム EFEMを開発

2009年11月

半導体関連設備である450mmウェーハに対応する搬送システム EFEM(Equipment Front End Module)を開発いたしました。

今回の開発は、現在半導体業界で主流となっている300mmウェーハから、さらに大口径の450mmウェーハ実用化に向けた新たな取り組みの一つです。これにより、ウェーハの面積および重量は2倍以上となり、その重量に耐えうるロボットの剛性や、クリーンな環境で品質を保ちながら高速搬送を可能にする技術が求められます。今後は、真空ロボット・センターチャンバーと組み合わせたプラットフォームの開発なども進める予定です。

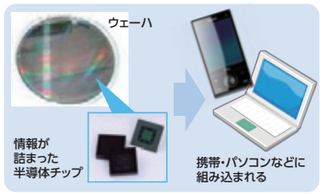


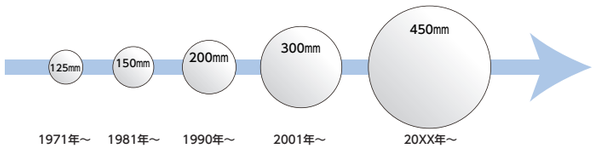
450mmウェーハ対応搬送システムEFEM

Semicon JAPAN2009に出展した試作機

ウェーハの大口径化とは?

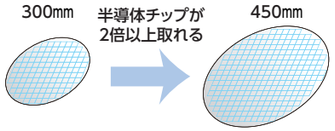
ウェーハとは、携帯やパソコンなどの半導体機器に使われている半導体チップの原材料となる、薄い円形の基板です。高性能を追求しながら増える需要に対応するために、主流のウェーハサイズは約10年に1度の間隔で大きくなってきています。





大口径化のメリットとは?

ウェーハサイズが450mmになることで、300mmウェーハと比べると2倍以上の半導体チップが生産できます。より多くの半導体チップを一度に生産するので生産性も高まり、市場の需要と価格に応えることができ、また生産工程に必要な電力や水などの資源を節約することができます。



インテル コーポレーションから 「プリファード・クオリティー・サプライヤー(PQS)賞」を受賞

2010年3月

インテル コーポレーションより2009年度 プリファード・クオリティー・サプライヤー(PQS)賞を受賞しました。

半導体分野

PQS賞はインテルの業績に大きく貢献した製品・サービスを提供し、優れた対応をおこなった企業に贈られる賞で、当社は、インテルの成功に欠かせない搬送装置を供給したとして、今回の受賞となりました。当社代表取締役社長の米田康三は、「当社の実績が評価され、大変光栄に思います。今後もお客さまに高品質でコスト効率に優れた生産設備をお届けし、継続受賞となるようグループ会社含めOne Hirataで取り組みます」と意気込みを述べました。

2009年度PQS賞のクリスタルトロフィー

Hirataは各分野のお客様から名誉ある賞を受賞しています。

当社は、自動車関連・FPD関連・半導体関連など、多様な産業分野で常に成長を続けており、これまでも当社の技術力、サポート体制において高く評価され、お客様から名誉ある賞をいただいた実績があります。

自動車分野

トヨタ自動車株式会社から 「2007年度 技術開発賞」を 受賞

2008年

部品・資材、設備などの分野において技術的な貢献をしたと認められる企業に対して贈られる賞で、当社の新型減圧リフロー炉について、新しい技術に挑戦し、品質向上と省エネを達成したとして高く評価されました。

FPD分野

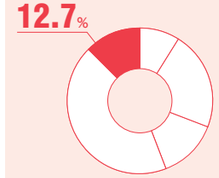
シャープ株式会社から 「LCD(Liquid Crystal Display) アワード設備部門賞」を受賞

2006年

シャープ株式会社の業績に大きく貢献したと認められる企業に与えられる賞です。当社は、お客様の工場の生産立ち上げが計画より早まった際に、品質を保証しながら、納期を守った積極的な協力と貢献が評価されました。

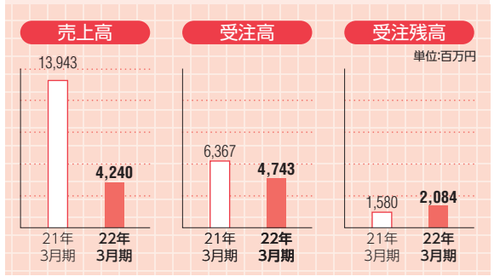
自動車関連生産設備事業

エンジン、トランスミッションなどの自動車の駆動系主要部品をはじめ、制御用電子機器、車載用電子部品などの組立設備の製造・販売



売上高 42億円

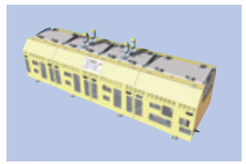
対前年同期増減率 △69.6%



第59期実績

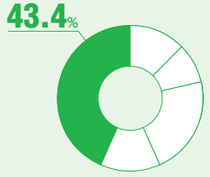
中国市場においては、設備投資意欲の回復が見られますが、主力の北米および国内市場については依然として設備投資の手控えが続いており、受注価格の低下など厳しい状況の下、売上高は42億40百万円(前期比69.6%減)となりました。今後は既存のお客様への深耕を図ることに加え、新規お客様に対し積極的な営業活動を展開し、受注の拡大を図ります。

フレキシブルキャリア組立機


リフロー炉

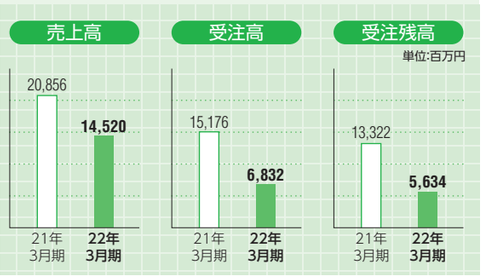
FPD関連生産設備事業

液晶・PDP(プラズマ・ディスプレイ・パネル)のもととなるガラス基板を搬送するシステム、ガラス基板に感光剤を塗布する装置の製造・販売



売上高 145億円

対前年同期増減率 △30.4%



第59期実績

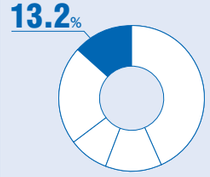
前期に受注した国内での大型パネル対応設備をはじめとする大型案件の売上を予定どおり計上しましたが、国内および中国、台湾市場における厳しい市場環境の影響を受け、前期の水準には至らず売上高は145億20百万円(前期比30.4%減)となりました。今後は、太陽電池事業においても液晶基板の搬送技術を活かしたトータル搬送システムを提供すべく積極的に受注活動を展開していきます。

第10世代ガラス基板搬送ロボット

ソーラーモジュール組立装置

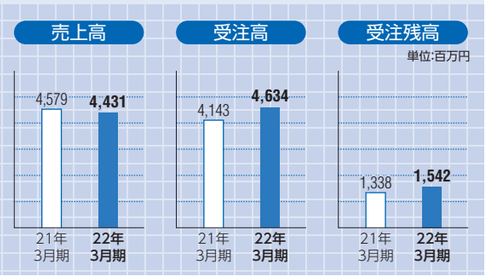
半導体関連生産設備事業

ロードポート、ウェーハ搬送ロボット、EFEM(ウェーハの処理を行うプロセス装置の前面にあり、ロードポートやロボットを組み込んだ装置)の製造・販売



売上高 44億円

対前年同期増減率 △3.2%



第59期実績

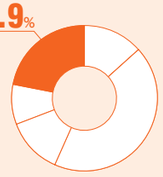
半導体市場の回復基調により、半導体メーカーの設備投資も活発化の兆しが見られるようになり、一部の大型製造受託案件の売上を計上しましたので、売上高は44億31百万円(前期比3.2%減)となりました。当社は、当期間に開発した450mmウェーハ搬送システムEFEMに加え、今後は真空ロボット、真空センターチャンバーと組み合せたプラットフォームの開発も進めていく予定です。

ロードポート

ウェーハ搬送ロボット

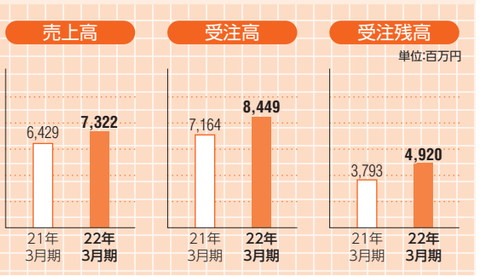
物流機器および家電関連生産設備事業

家電関連分野では、薄型テレビ、冷蔵庫などの自動組立設備、タイヤ関連分野では、タイヤ搬送機、タイヤ仕分け機などを製造・販売



売上高 73億円

対前年同期増減率 13.9%



第59期実績

家電関連分野では、受注高および売上高ともに低調に推移しておりましたが、積極的な営業活動を展開したことにより、薄型テレビをはじめとする家電業界向け設備およびタイヤ業界向けの設備において受注高の確保ができた結果、売上高は73億22百万円(前期比13.9%増)となりました。今後は、新興国市場および北米、欧州においてタイヤ設備の営業活動を強化し受注の拡大を図ります。

自動倉庫

精密機器自動組立設備

連結財務諸表（要約）

■連結貸借対照表

（単位:百万円）

科　目	前連結会計年度（21.3.31現在）	当連結会計年度（22.3.31現在）
【資産の部】		
流動資産	44,877	31,018
現金及び預金 ①	11,116	10,121
受取手形及び売掛金 ②	20,482	15,413
たな卸資産 ③	10,671	3,764
繰延税金資産	1,776	1,473
その他	958	361
貸倒引当金	△ 128	△ 115
固定資産	22,828	20,776
有形固定資産	16,765	16,115
建物及び構築物（純額）	5,153	4,851
土地	9,866	9,819
その他	1,745	1,444
無形固定資産	354	392
投資その他の資産	5,708	4,268
投資有価証券	1,648	1,747
破産更正債権等	2,648	706
繰延税金資産	2,748	2,002
その他	423	450
貸倒引当金	△ 1,761	△ 639
資産合計	67,705	51,794

（単位:百万円）

科　目	前連結会計年度（21.3.31現在）	当連結会計年度（22.3.31現在）
【負債の部】		
流動負債	34,088	22,313
支払手形及び買掛金 ④	10,877	6,355
短期借入金	16,561	5,306
一年以内返済予定の長期借入金 ⑤	1,664	6,638
一年以内償還予定の社債	850	850
賞与引当金	116	45
その他	4,018	2,563
固定負債	17,001	12,846
社債	2,850	2,000
長期借入金 ⑤	8,707	5,575
退職給付引当金	1,966	1,718
その他	3,477	3,552
負債合計	51,090	35,159
【純資産の部】		
株主資本	12,780	12,742
資本金	2,633	2,633
資本剰余金	2,322	2,322
利益剰余金	8,066	8,029
自己株式	△ 243	△ 243
評価・換算差額等	3,569	3,624
少数株主持分	265	267
純資産合計	16,615	16,635
負債純資産合計	67,705	51,794

ポイント

① 現金及び預金
現金及び預金は、回収した売掛金は主に借入金の返済に充当しましたが、前期末と同様に経営上の諸リスクに備えるため、手元資金を多めに確保した結果、前期比9億94百万円減の101億21百万円となりました。

② 受取手形及び売掛金
受取手形及び売掛金は、前年度に売上を計上した大型案件や子会社の売掛金回収が進み、前期比50億68百万円の減少となりました。

③ たな卸資産
たな卸資産は、今期から適用された工事進行基準の影響により仕掛品が大幅に減り、前期比69億07百万円の減少となりました。

④ 支払手形及び買掛金
支払手形及び買掛金は、生産高の減少に伴い、仕入及び外注費が減少したことに加え、内製を強化した結果、前期比45億21百万円の減少となりました。

⑤ 有利子負債
有利子負債は、売掛金回収による返済が進み、前期比102億63百万円の減少となりました。

■連結損益計算書

（単位:百万円）

科　目	前連結会計年度（自 20.4.1 至 21.3.31）	当連結会計年度（自 21.4.1 至 22.3.31）
売上高 ⑥	49,710	33,455
売上原価	45,984	28,375
売上総利益	3,726	5,079
販売費及び一般管理費	6,067	4,715
営業利益（損失） ⑦	△2,340	364
営業外収益	144	182
営業外費用 ⑧	748	365
経常利益（損失） ⑦	△ 2,944	180
特別利益 ⑨	82	1,193
特別損失	1,781	187
税金等調整前当期純利益（損失）	△ 4,643	1,187
法人税等	△ 1,688	1,138
少数株主利益（損失）	△ 9	4
当期純利益（損失）	△ 2,945	43

■連結キャッシュフロー計算書

（単位:百万円）

科　目	前連結会計年度（自 20.4.1 至 21.3.31）	当連結会計年度（自 21.4.1 至 22.3.31）
営業活動によるキャッシュ・フロー ⑩	△ 5,344	9,656
投資活動によるキャッシュ・フロー ⑪	△ 1,670	△ 329
財務活動によるキャッシュ・フロー ⑫	13,166	△ 10,340
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 239	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,912	△ 994
現金及び現金同等物の期首残高	5,203	11,116
現金及び現金同等物の期末残高	11,116	10,121

ポイント

⑥ 売上高
売上高については、有機EL関連・太陽光発電などの新規分野での受注を確保しましたが、従来分野での設備投資抑制の影響が大きく、前期比32.7%減の334億55百万円となりました。

⑦ 営業利益・経常利益
営業利益および経常利益については、左記新規分野の案件の売上、工事進行基準によるプラス影響があり、一方で外注費をはじめとした変動費削減、緊急対策としての固定費削減などの努力により、修正計画値を上回る利益を計上することができました。

⑧ 営業外費用
営業外費用については、借入金返済による支払利息の減少や前期に計上されていたコミットメントラインの組成費用等がなかったことなどにより、前期比3億82百万円の減少となりました。

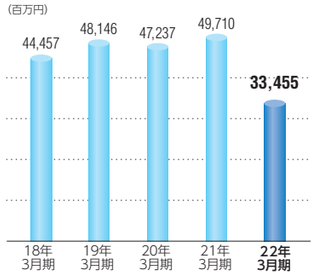
⑨ 特別利益
特別利益は、売上債権の回収に伴い、貸倒引当金を戻し入れた結果、前期比11億11百万円増加しました。

⑩ 営業活動によるキャッシュフロー
営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益11億87百万円、減価償却費9億円に対して、貸倒引当金が11億35百万円、売上債権が71億59百万円、たな卸資産が69億37百万円、仕入債務が46億58百万円それぞれ減少したことにより、96億56百万円の増加となりました。

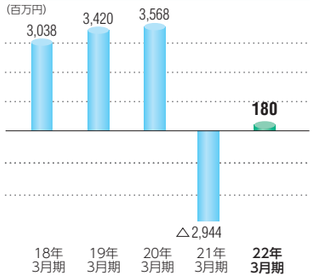
⑪ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金は、有形固定資産の取得1億13百万円、無形固定資産の取得1億89百万円等により、3億29百万円の減少となりました。

⑫ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金は、有利子負債の削減を推進するために、借入金および社債の返済・償還を併せて101億72百万円実施したことと、配当金の支払いを1億5百万円実施したことにより、103億40百万円の減少となりました。

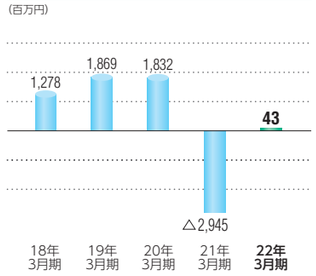
売上高



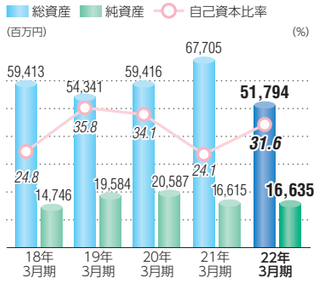
経常利益(損失)



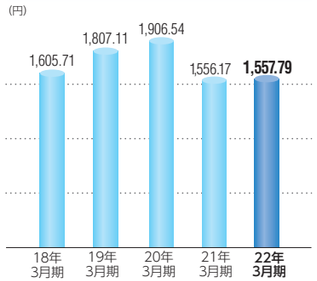
当期純利益(損失)



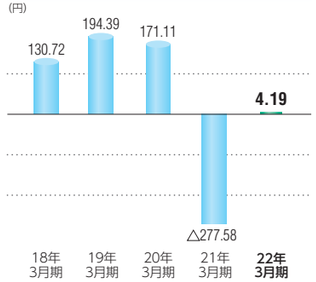
総資産／純資産



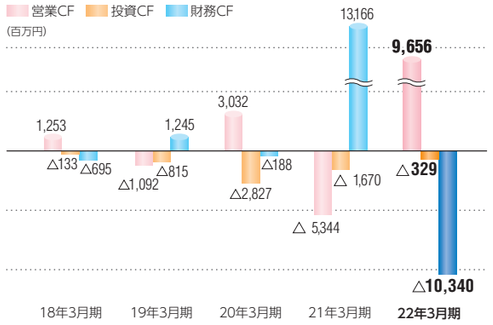
1株あたり純資産額



1株あたり当期純利益(損失)

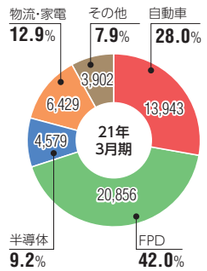


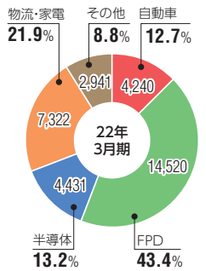
キャッシュ・フロー



事業別売上高および比率

(百万円)





会社概要(平成22年6月24日現在)

会社名	平田機工株式会社
会社設立	1951年12月29日
資本金	2,633百万円
従業員数	1,837名(連結　平成22年3月31日現在)
業務内容	各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売
本社所在地	東京都品川区戸越3丁目9番20号

役員	代表取締役会長	平田　耕也	執行役員　堤　春生
	代表取締役社長	米田　康三	執行役員　藤原　五男
	取締役副社長執行役員	平田雄一郎	執行役員　藤本　勝
	取締役専務執行役員	橘　勝義	執行役員　平賀　靖英
	取締役執行役員	坂本　広徳	執行役員　大田　謙次
	取締役執行役員	松永　盛文	
	取締役執行役員	田中　敏治	
	取締役	平田　宏之	
	常勤監査役	小川　克眞	
	監査役	村田　邦夫	
	監査役	山田　昭	
	監査役	中村　洋一	

株式の状況(平成22年3月31日現在)

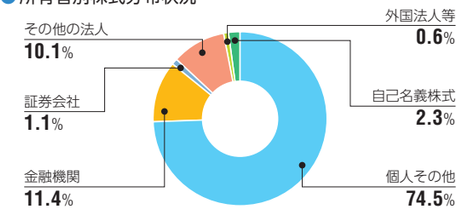
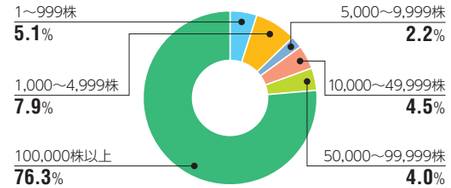
●発行可能株式総数	37,000,000 株
●発行済株式総数	10,756,090 株
●株主数	2,845 名

■大株主の状況

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
平田　耕也	994,462	9.25
平田機工社員持株会	791,910	7.36
平田　紀生	575,162	5.35
SMC株式会社	500,000	4.65
平田　宏之	464,972	4.32
平田　満	457,629	4.25
株式会社肥後銀行	456,000	4.24
平田　雄一郎	401,900	3.74
平田　滋夫	363,044	3.38
有限会社コンパス	224,000	2.08

上記のほか、当社が保有している自己株式が249,387株あります。

●所有者別株式分布状況



●所有株数別株式分布状況